

PRESSEINFORMATION

01.11.2003

WLP jetzt auch mit optischen Fenstern - Waferlevel Packaging von MEMS mit zusätzlichen Features ausgestattet

BERLINER GLAS fertigt hochgenau strukturierte Glaswafer für das WLP von MEMS (Ebene 0).

Mit einem innovativen Fertigungsverfahren können komplex strukturierte Kapselungswafer in hoher Genauigkeit zu vergleichsweise geringen Kosten hergestellt werden. Glaswafer aus Borosilikatglas im Format bis 6" können mit folgenden Features ausgestattet werden:

- Angepaßter thermischer Ausdehnungskoeffizient zum Silizium-Wafer
- Große Gestaltungsfreiheit der Cavities, auch nicht uniforme Tiefen
- Integration definierter offener Bereiche (Durchbrüche)
- Integration von metallischen Durchkontakten (Vias) zur Erhöhung der Packungsdichte (in Planung)
- Integration optischer Fenster für den Einsatz bei MO EMS
- Enge Form- und Positionstoleranzen
- Hohe Ebenheit und Parallelität; geringe Rauigkeit
- Bondfertig (Metallbond, anodischer Bond, etc.)

BERLINER GLAS bietet mit diesem Produkt für eine breite Palette von MEMS, RF-MEMS und MÖMS eine kostengünstige und industriell nutzbare Waferlevel-Kapselungs-Lösung mit großem Kundennutzen an.

Pressekontakt:

Berliner Glas KGaA
Herbert Kubatz GmbH & Co.
Waldkraiburger Str. 5
D-12347 Berlin
www.berlinerglas.de

Astrid Freiding
Marketing/Communications
Tel: 030/60905-368
Fax: 030/60 90 5-100
freiding@berlinerglas.de